公司代码:688249　　公司简称:晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	晶合集成	688249	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱才伟	曹宗野
联系地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号
电话	0551-62637000转612688	0551-62637000转612688
传真	0551-62636000	0551-62636000
电子信箱	stock@nexchip.com.cn	stock@nexchip.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事12英寸晶圆代工业务,致力于研发及应用行业先进的工艺,为客户提供不同工艺平台、多种制程节点的晶圆代工服务。

在晶圆代工制程节点方面,公司目前已实现150nm至40nm制程平台的量产,28nm OLED产品持续验证中,28nm逻辑工艺平台已完成开发。在工艺平台应用方面,公司目前已具备DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU等工艺平台晶圆代工的技术能力。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、工业控制、人工智能、物联网及存储等领域。

2.2主要经营模式

1.研发模式

公司制定了研发管理制度,明确了研发过程中各部门的权责关系与作业流程,确保研发过程符合公司策略发展方向,实现经营效益最大化。公司研发流程包括市场调查、策略制定、可行性评估、项目审查、项目立项、技术开发、流片、工艺制程验证、项目结案等环节。

为保证研发效率及成本控制,公司还制定了严格的研发进度管控方案,覆盖前期产品市场信息汇整、策略方向讨论、可行性评估、项目审查以及研发的各个环节。

2.采购模式

公司的供应商主要包括原材料供应商和设备供应商,公司通常采用直接采购模式,如果终端供应商采取经销模式进行销售,则公司也可通过经销商向终端供应商进行采购。

为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量、提高生产效率和存货周转效率,公司建立了严格的采购流程,具体如下:

公司建立了完善的供应商认证准入机制和严格的供应商考核评价体系,以保证原材料、设备零配件及设备质量的稳定性和供应的持续性。供应商经过资质评估、采购效益评估、入厂评估等环节评估通过后,方可成为公司的合格供应商,公司主要向进入公司合格供应商名单的供应商进行采购。为实现对合格供应商的有效管理,相关部门会对采购产品的质量、价格、服务等进行考核评价。

3.生产模式

公司接到客户需求后,首先进行小规模试产;在良率及工艺条件稳定后,进入风险量产阶段;在各项交付指标达标后,与客户签订正式的销售合同或接受批量订单,按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产。

4.销售模式

公司建立了规范、完整的销售团队,拥有多元化的营销渠道,通过不同的营销方式拓展客户。主要方式如下:

(1)通过市场分析,挖掘潜在客户,并主动与潜在客户进行沟通,举办业务洽谈会,主动向客户推荐符合客户需求的技术平台;

(2)通过与晶圆代工上下游的企业及行业协会沟通交流,开发潜在客户;

(3)通过参与学术交流、半导体峰会、行业展会、技术论坛、企业论坛等活动,塑造公司形象,获取潜在客户;

(4)通过公司官网、新闻媒体等公开渠道,展示公司的工艺平台与技术水平,由潜在客户主动联系公司开展业务合作。

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度,对销售流程进行规范。公司销售流程如下:客户需求可行性评估、依据产品规格对产品报价、接收客户订单、生产制造、出货至客户指定地点、客户付款。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事12英寸晶圆代工业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”(分类代码:1.2.1)、“集成电路制造”(分类代码:1.2.4)。

集成电路行业呈现垂直化分工格局,其产业链是一个高度专业化和分工明确的产业链,上游包括集成电路材料、集成电路设备等;中游为集成电路生产,集成电路生产环节亦呈现垂直化分工格局,可以具体划分为集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测;下游为各类终端应用。

公司处于集成电路晶圆代工行业,专门负责晶圆制造,为集成电路设计公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业,其芯片制造工艺高度复杂、所需原材料和设备种类繁多、制造周期长,不仅需要全球产业链的支持,还依赖深厚的专业知识储备、工程人才支撑以及持续的技术创新与工艺积累,因此行业具有较高的进入壁垒。

在市场需求驱动下,近年来全球晶圆代工市场增长态势强劲,产业规模加速扩容。从竞争格局看,台积电等企业在先进制程领域占据领先地位,国内企业虽在不断追赶,但在核心技术、先进制程等方面仍与国际巨头存在差距。在全球供应链格局深度调整与地缘政治不确定性增加的背景下,国内企业不断调整市场策略,持续加大研发投入,深耕特色工艺及特定细分市场,强化产业链协同,加速国产化替代,以成熟制程规模优势构建差异化竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

晶合集成是一家领先的12英寸晶圆代工企业,拥有领先的工艺制造能力、产能优势。根据TrendForce公布的2025年第四季度全球晶圆代工业者营收排名,晶合集成位居全球第九位,在中国大陆企业中排名第三。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①显示驱动芯片迎来发展机遇

显示驱动芯片的技术改革将跟随多样化的终端产品需求而变化。目前LCD显示屏仍占据着大部分市场,相较于LCD显示技术,OLED有更轻薄、更具柔性、更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度等优势,未来随着技术的不断发展和对显示成像更高的追求,OLED技术将成为主流趋势。目前韩国企业在OLED显示驱动芯片领域具有领先的技术优势,但国内企业在政策支持和产能扩张的双重推动下,不断加大研发投入,已经取得了一定的技术突破,市场份额正在逐步提升。国内面板企业对供应链自主可控的需求不断增强,会更倾向于选择国内的显示驱动芯片供应商,这为公司带来了更多的市场机会。

作为将现实与虚拟场景连接的硬件载体,近年来AR/VR/MR相关产品备受关注,新兴应用对高分辨率、小尺寸、低功耗的近眼显示需求增加,叠加半导体发展,微显示技术成为未来增长的新方向,形成增量市场。Omdia预测,2026年AR/VR/MR领域的近眼显示市场收入将达到12亿美元,同比增幅超200%。这一增长的核心驱动力,是硅基OLED技术在智能眼镜、头戴显示设备中的广泛应用。

报告期末,公司28nm OLED产品持续验证中,40nm高压OLED显示驱动芯片、110nm Micro OLED芯片均已实现批量生产。

②CIS国产化进程加快

CIS是一种将光学影像转换为数字信号的半导体器件,具有高集成度、低功耗和快速数据处理能力等特点,广泛应用于消费电子、安防监控及智能驾驶等领域。全球CIS市场正处于高速增长期,Yole数据显示,2024年市场规模为232亿美元,预计到2030年将增长至301亿美元,年复合增长率维持在4.4%左右。从近三年数据来看,2023年市场规模为218亿美元,2024年较2023年增长6.42%。对比国内外龙头企业市场份额,索尼、三星等海外巨头仍占据主导地位,与此同时,中国CIS市场规模在全球市场中的比重逐渐提升,国内豪威集团、思特威、格科微等企业通过技术突破与产品迭代在全球CIS市场份额不断增加。CIS行业整体国产化率的提升,离不开产业链协同的深化,国内CIS企业通过与本土晶圆厂建立深度合作,获得稳定的产能供应,为持续扩大市场份额奠定基础。

公司CIS产品制程覆盖90-55nm,广泛用于智能手机主摄、辅摄及前摄镜头,以及车载摄像头等场景。报告期末公司55nm全流程堆栈式CIS芯片已实现批量生产。

③汽车半导体市场快速增长

新能源汽车的半导体使用量是传统内燃机汽车的数倍,具备辅助驾驶和智能座舱功能的汽车芯片用量更高。当前随着全球化新能源汽车产业发展,汽车“新四化”转型步伐日渐加快,汽车芯片成为提升智能驾乘体验的重要载体,迎来高速发展浪潮,国产品牌凭借国内成熟产业链和软硬件创新优势逐步实现弯道超车,进而带动本土汽车电子供应链迎来市场导入的机会窗口。

公司积极配合汽车产业链的需求,布局车用芯片市场。在汽车芯片制造能力建设上,公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证,并通过多个工艺平台的车规验证。目前公司已实现首颗车规MCU产品风险量产,并成功导入国内头部车厂供应链。

④电源管理芯片需求增长

电源管理芯片是在电子设备系统中实现对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,是电子产品和设备的电能供应中枢和纽带,是电子产品中不可或缺的关键器件。SEMI、弗若斯特沙利文数据显示,中国PMIC市场由2020年的10亿美元增长至2024年的16亿美元,复合年增长率为12.5%。预计到2029年达到28亿美元,复合年增长率为10.2%。受消费电子、汽车电子和工业应用等下游领域的需求持续增长推动,本土市场对电源管理芯片的需求不断增长,为了保障供应链安全,国内电源管理芯片产业正在积极推进国产化替代进程,国内终端厂商将更多地选用国产芯片替代海外芯片。

2025年电源管理芯片占公司主营业务收入的比例为12.16%,公司已开展AI服务器相关电源管理芯片研发,其中90nm BCD产品持续验证中。

⑤逻辑芯片国产化提升空间巨大

目前成熟制程逻辑芯片在规模庞大、增长稳健的非高性能场景中仍占据主导地位,在消费电子、汽车电子以及工业控制与通信等领域发挥着不可替代的作用。未来随着国产化率的提高和技术创新的加速推进,国内逻辑芯片产业将迎来更加广阔的发展空间。

公司与战略客户展开深度合作,目前55nm逻辑产品已实现批量生产,28nm逻辑工艺平台已完成开发。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	53,297,969,296.77	50,398,579,443.20	5.75	48,156,279,600.77
归属于上市公司股东的净资产	21,768,532,119.02	20,870,311,007.81	4.30	21,409,804,721.09
营业收入	10,885,449,273.30	9,249,252,348.20	17.69	7,243,541,372.63
利润总额	466,694,437.03	482,459,402.07	-3.27	119,340,389.16
归属于上市公司股东的净利润	704,204,446.26	532,840,611.25	32.16	211,629,145.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,038,175.11	394,366,803.85	-48.77	47,129,534.95
经营活动产生的现金流量净额	3,842,919,898.34	2,761,131,250.90	39.18	-161,035,964.85
加权平均净资产收益率(%)	3.31	2.52	增加0.79个百分点	1.09
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33	0.12
研发投入占营业收入的比例(%)	13.35	13.88	减少0.53个百分点	14.60

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,567,682,999.65	2,630,771,703.69	2,931,263,561.46	2,755,731,018.50
归属于上市公司股东的净利润	135,472,184.74	196,696,574.13	218,041,780.18	154,033,907.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,598,689.06	81,232,844.64	23,989,629.39	-25,782,987.98
经营活动产生的现金流量净额	586,407,326.79	1,118,627,580.27	969,280,900.20	1,168,604,091.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	0	468,474,592	23.34	468,474,592	无	0	国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	0	328,736,799	16.37	328,736,799	无	0	其他
力晶创新投资控股股份有限公司	-120,368,109	262,364,072	13.07	0	无	0	境外法人
华勤技术股份有限公司	120,368,109	120,368,109	6.00	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-5,104,936	39,149,414	1.95	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,394,094	36,600,502	1.82	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	15,589,238	25,148,295	1.25	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,482,994	22,758,439	1.13	0	无	0	其他
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	0	13,202,118	0.66	0	无	0	其他
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	/	13,051,964	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		合肥芯屏与合肥建投为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

注:根据公司2024年12月末的股东名册,“银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)”未出现在前200名股东之中,因此公司无法具体确定该股东在报告期内实际增减的股份数量。

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24晶合集成MTN001(科创票据)	102483400	2029-08-09	800,000,000	1.90
合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25晶合集成MTN001(科创债)	102582055	2030-05-14	200,000,000	1.85
合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25晶合集成MTN002(科创债)	102582892	2030-07-15	1,000,000,000	1.71

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	合肥晶合集成电路股份有限公司于2025年8月7日支付24晶合集成MTN001(科创票据)第一年债券利息,利息金额1,520.00万元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.30	48.23	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	202,038,175.11	394,366,803.85	-48.77
EBITDA全部债务比(%)	23.85	22.99	增加0.86个百分点
利息保障倍数	1.68	1.68	-

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,088,544.93万元,较上年同期增长17.69%;实现净利润46,649.84万元,较上年同期下降3.26%;归属于上市公司股东的净利润为70,420.44万元,较上年同期增长32.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,203.82万元,较上年同期下降48.77%;实现经营性现金流量净额384,291.99万元,较上年同期增长39.18%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688249　　证券简称:晶合集成　　公告编号:2026-006

合肥晶合集成电路股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

●2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

●公司2025年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式,并结合公司未来研发投入需求、产能扩充等长期战略发展规划,以及全体股东长远利益的综合考虑。

●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,420.44万元,2025年末合并报表中未分配利润为144,226.68万元,公司母公司报表中期末未分配利润为176,472.45万元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定,综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段、自身经营模式、未来研发投入需求以及产能扩充等长期战略规划,为保障公司持续稳定经营,更好地维护全体股东的长远利益,经公司审慎研究讨论,拟定公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	194,404,665.70	/
回购注销总额(元)	0	0	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	704,204,446.26	532,840,611.25	/
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,764,724,521.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	194,404,665.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	618,522,528.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	194,404,665.70		
现金分红比例(%)	31.43		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	2,737,375,384.44		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	20,134,701,621.50		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	13.60		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司于2023年5月5日在上海证券交易所科创板上市,根据《科创板股票上市规则》规定,公司上市不满三个完整会计年度的,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度,故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度、2025年度。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度拟不进行利润分配,是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式,并结合公司未来研发投入需求、产能扩充等长期战略发展规划,以及全体股东长远利益的综合考虑,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事12英寸晶圆代工业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。公司所处的晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业,需要大量的资本支出和人才投入,具有较高的进入壁垒。

(二)公司盈利水平及资金需求

2025年度,公司实现营业收入1,088,544.93万元,较上年同期增长17.69%;实现归属于上市公司股东的净利润70,420.44万元,较上年同期增长32.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,203.82万元,较上年同期下降48.77%。

2026年,公司将基于产能扩充、业务布局和研发计划,进一步吸纳并培养优秀高科技人才,加大重要研发项目的投入,同时拓展国内外客户并加深合作粘性,为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此,公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度,主要用于公司设备购置、产能扩充、经营周转、研发投入、人才引进等方面。公司将持续提升综合竞争力,切实推动公司长期战略发展规划的落地实施,持续增强公司的盈利能力,更好地维护公司及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配,充分考虑了行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求,符合相关法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投入及生产经营发展的资金需求等因素,不会对公司的现金流产生重大影响,亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688249　　证券简称:晶合集成　　公告编号:2026-007

合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)954号)同意,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)501,533,789股。公司每股发行价格19.86元,募集资金总额为9,960,461,049.54元,扣除发行费用236,944,589.63元后,募集资金净额为9,723,516,459.91元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月26日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0099号)。

截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加:未置换的以自有资金支付的发行费用(印花税)	2,431,486.99
加:利息收入扣除银行手续费净额	121,910,882.62
减:募集资金投资项目支出(a=b+c+e)	8,785,813,265.09
其中:直接投入募集资金项目的金额(a)	5,264,295,448.59
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,446,293,262.09
减:节余资金永久补充流动资金	701,107,797.75
减:超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减:超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减:报告期未尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	0
截至2025年12月31日募集资金专户应有余额(d)	136,417,069.12
截至2025年12月31日募集资金专户实际余额(e)	136,417,069.12
差异(d-e)	0

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年4月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥晶合集成电路股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	200005154184666000000057	133,958,919.36	2026年3月19日销户
	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	200005154184666000000164	23,100.83	2026年3月19日销户
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	0	2026年3月18日销户
	中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	0	2026年3月18日销户
	招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	/	2024年7月17日销户
	兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	/	2024年7月19日销户
	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	/	2024年5月17日销户
	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,435,048.93	2026年3月19日销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,使用不超过人民币20亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,使用不超过人民币15亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为133,858,919.36元,均为协定存款。报告期内购买的券商收益凭证均已到期赎回。

募集资金现金管理明细表

单位:万元币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年4月26日						
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利81期浮动收益凭证	保本浮动收益	20,000.00	2024/7/10	2025/1/6	2025/1/7	0	2%-3%	197.26
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利82期浮动收益凭证	保本浮动收益	20,000.00	2024/7/10	2025/1/6	2025/1/7	0	2%-2.8%	236.71
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈37期浮动收益凭证	保本浮动收益	10,000.00	2024/7/31	2025/2/5	2025/2/7	0	1.8%-4%	208.22
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈38期浮动收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/8/7	2025/2/11	2025/2/13	0	1.8%-4%	103.56
晶合集成	中国中金财富证券有限公司	中金公司金添鑫动195号收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/10/18	2025/1/20	2025/1/23	0	1.2%-3%	32.07
晶合集成	中国中金财富证券有限公司	中金公司金承鑫动196号收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/10/18	2025/4/21	2025/4/25	0	1.2%-3%	35.66
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈62期浮动收益凭证	保本浮动收益	10,000.00	2024/10/31	2025/5/6	2025/5/22	0	1.5%-3.7%	190.58
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制600期	保本固定收益	10,000.00	2025/1/8	2025/5/27	2025/5/29	0	2.02%	76.93
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利116期	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/8	2025/5/27	2025/5/29	0	1.77%-2.4%	67.41
晶合集成	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列173期	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/9	2025/5/27	2025/5/27	0	1.6%-1.73%	13.08
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈77期	保本浮动收益	5,000.00	2025/1/24	2025/5/26	2025/5/29	0	1.4%-3%	23.59
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈79期	保本浮动收益	10,000.00	2025/2/10	2025/5/26	2025/5/29	0	1.4%-3%	40.66
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈80期	保本浮动收益	5,000.00	2025/2/14	2025/5/26	2025/5/29	0	1.4%-3%	19.56
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈108期	保本浮动收益	5,000.00	2025/5/13	2025/8/12	2025/8/18	0	1.2%-2.6%	22.43